



LEXCMGX

Laminate

R-1515A

Prepreg

R-1410A

低熱膨張半導体パッケージ基板材料

優れた弾性と耐熱性を有し、多ピン化・伝送回路集積化に伴う大型パッケージの高機能化に貢献

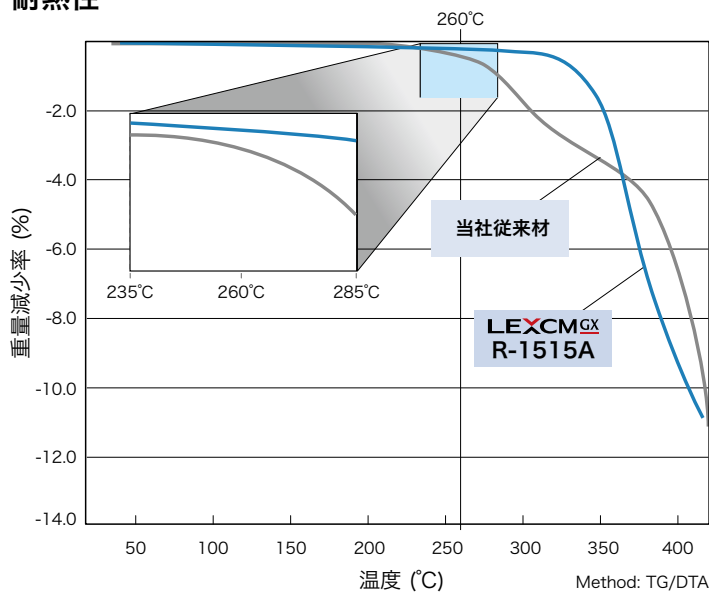
曲げ弾性率
25°C 27GPa

CTE x,y-axis
11-13ppm/°C

Tg(DMA) 205°C

用途
半導体パッケージ
半導体パッケージ基板

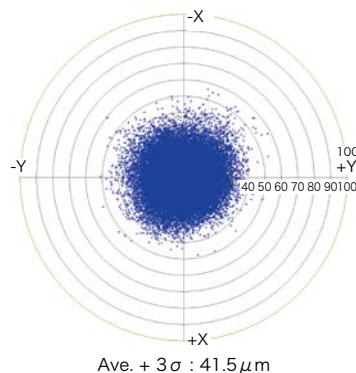
耐熱性



260°C 重量減少

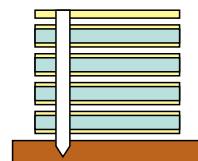
LEXCMGX R-1515A	0.2%
当社従来材	0.5%

穴位置精度



評価条件

ドリルサイズ	0.15mm φ
フルート長さ (ℓ)	3.0mm
回転数	200krpm
チップロード	10 μm/rev
ヒット数	20,000
エントリーボード	LE 800
板厚	0.4mm
銅箔厚み	12/12 μm
重ね枚数	4



一般特性

項目	試験方法	条件	単位	LEXCMGX R-1515A
ガラス転移温度(Tg)	DMA※2	A	°C	205
熱分解温度(Td)	TGA	A	°C	390
熱膨張係数(タテ方向)	社内法	A	ppm/°C	11-13
熱膨張係数(ヨコ方向)				
曲げ弾性率※1	JIS C 6481	25°C	GPa	27
		250°C		10

試験片の厚さは0.1mmです。

※1 0.8mm ※2 曲げモードでの測定

商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

当社ハロゲンフリー材料は、JPCA-ES-01-2003などの定義によるものです。

上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。